

<新刊レポートのご案内>

PCBレポート2024

- ・発刊予定日: 2024年7月18日
- ・体裁: A4 / 約230頁
- ・価格(税込): コーポレート契約: 440,000円
グローバル契約: 594,000円

株式会社 ジャパンマーケティングサーベイ

〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-24-12 東日本橋榎町ビル8F

| TEL: 03-5829-3891 | FAX: 03-5829-3892 | E-mail: info@jms21.co.jp | <https://www.jms21.co.jp>

調査のポイント

- ◆ PCB市場の現状(2023年)及び今後の2033年までの市場予測を分析
 - 基板種類別：片面/両面/多層(4-10層/12-20層/22+層)/HDI/IC基板/FPC&RF/他
 - 応用分野別：コンピュータ/モバイル/通信インフラ/民生/車載/産業・医療/軍需・航空
 - 数量/金額ベース
- ◆ ZDT/Unimicron/DSBJを始め、中国・台湾/日本/韓国/欧米の上位48社の販売動向を詳細に調査/分析し、そのメーカー別シェアを基板種類別/応用分野別に把握
- ◆ これらの上位メーカーの事例研究（設備投資/生産拠点・能力/販売状況等）

目次

第1章 総括

第2章 PCBの市場動向

2-1. PCBの種類別市場規模予測

PCBの種類別市場規模予測(金額/数量)

コンピュータ分野向け基板の市場規模予測(金額/数量)

携帯端末分野向けの基板市場規模予測(金額/数量)

通信インフラ分野向けの基板市場規模予測(金額/数量)

民生分野向けの基板市場規模予測(金額/数量)

自動車分野向けの基板市場規模予測(金額/数量)

産業・医療分野向けの基板市場規模予測(金額/数量)

軍需・宇宙航空分野向けの基板市場規模予測(金額/数量)

ICサブストレート向けの市場規模予測(金額/数量)

2-2. PCBの応用分野別市場規模予測

応用分野別PCBの市場規模予測(金額/数量)

片面基板の市場規模予測(金額/数量)

両面基板の市場規模予測(金額/数量)

多層基板(4L-10L)の市場規模予測(金額/数量)

多層基板(12L-20L)の市場規模予測(金額/数量)

多層基板(22+L)の市場規模予測(金額/数量)

HDI基板の市場規模予測(金額/数量)

ICサブストレートの市場規模予測(金額/数量)

FPC&R/Fの市場規模予測(金額/数量)

その他の基板の市場規模予測(金額/数量)

2-3. PCBの市場動向(2023年)

PCBのグローバル市場規模(2023年)

PCBの種類別応用分野別市場規模(2023年)

2-3-1. 主要メーカーの基板種類別販売実績(2023年)

主要メーカーの基板種類別の販売実績(金額/数量)

片面基板の応用分野別の販売実績(金額/数量)

両面基板の応用分野別の販売実績(金額/数量)

多層基板(4-10L)の応用分野別の販売実績(金額/数量)

多層基板(12-20L)の応用分野別の販売実績(金額/数量)

多層基板(22+L)の応用分野別の販売実績(金額/数量)

HDI基板の応用分野別の販売実績(金額/数量)

ICサブストレートの応用分野別の販売実績(金額/数量)

FPC&R/F基板の応用分野別の販売実績(金額/数量)

その他の応用分野別の販売実績(金額/数量)

2-3-2. 主要メーカーの基板種類別販売実績((金額/数量))

主要メーカーの応用分野別の販売実績(金額/数量)

コンピュータ向け基板の種類別販売実績(金額/数量)

モバイル向け基板の種類別販売実績(金額/数量)

通信インフラ向け基板の種類別販売実績(金額/数量)

コンシューマ向け基板の種類別販売実績(金額/数量)

自動車向け基板の種類別販売実績(金額/数量)

産業・医療向け基板の種類別販売実績(金額/数量)

軍需・航空向け基板の種類別販売実績(金額/数量)

ICサブストレート向け基板の販売実績(金額/数量)

目次

第3章 事例研究

日本メーカー

NIPPON MEKTRON, LTD.

IBIDEN CO., LTD.

SHINKO ELECTRONIC INDUSTRIES CO., LTD.

MEIKO ELECTRONICS CO., LTD.

Nitto Denko Corporation

CMK CORPORATION

Fujikura LTD.

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Kyocera Corporation

台湾メーカー

Zhen Ding Tech. Group

Unimicron Technology Corporation

Tripod Technology Corporation

Nan Ya Printed Circuit Board Corporation

Compeq Manufacturing Co. Ltd.

FLexium Interconnect. Inc.

WUS Printed Circuit Co., Ltd.

HANNSTAR BOARD CORPORATION

KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP

Gold Circuit Electronics Ltd.

Taiwan PCB Techvest Co., Ltd.

Chin Poon Industrial Co., Ltd.

Unitech Printed Circuit Board Corporation
Career Technology (Mfg.) Co., Ltd.

中国メーカー

Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd.
Shennan Circuits Co., Ltd.

Kingboard Holdings Limited

Shenzhen Kinwong Electronic co., Ltd.

Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd.

Suntak Technology Co., Ltd.

Aoshikang Technology Co. , Ltd.

AKM Meadville Electronics (Xiamen) Co., Ltd.

Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co., Ltd.

Shengyi Electronics Co., Ltd.

韓国メーカー

Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.

Young Poong Group

BH CO., LTD.

Simmtech Co., Ltd.

Daeduck Electronic Co., Ltd.

LG Innotek Ltd.

ISU Petasys Co., Ltd.

SI FLEX CO., LTD

欧米メーカー

TTM technologies, Inc.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

レポートの申込み要項

1. 契約形態/価格（税込み）

1) コーポレートライセンス契約：440,000円

2) グローバルライセンス契約：594,000円

※ ご利用はコーポレート契約では同一法人内に限定され、グローバル契約は出資比率51%以上の子会社までとなります

※コーポレート/グローバルのどちらのライセンス契約も（レポート+電子ファイル）で納品されます。また、グローバルライセンス契約は後日英語版も納品されます。

2. お申し込み方法

添付の調査申込書に所定事項をご記入の上、弊社宛まで電子メール（info@jms21.co.jp）もしくはFAX(03-5829-3892)にご送付下さい。

3. お支払い条件

請求書発行日の翌月末日までに銀行振込にて、お支払い下さい。

4. 調査レポートのお取り扱い

上記のご契約形態に従ってその利用範囲を限定させていただきます。

その契約形態を越えての第三者への譲渡を禁止とし、お約束いただきます。

申込書

年 月 日

PCBレポート2024

申し込み形態（チェック☑お願いいたします）： コーポレート契約 グローバル契約

※前頁の「調査レポートのお取り扱い」に合意の上申込みます。

申込企業名： _____

申込責任者： _____ 同役職： _____

連絡担当者： _____

同所属： _____

所在地：（〒 _____ ） _____

TEL： _____ E-mail： _____

金額： _____（税込）

連絡事項：

--